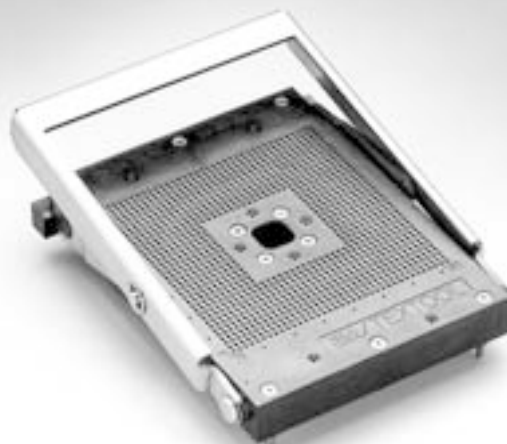


SPGA

Textool™ Sockets For Test and Burn In

SPGA ソケット

- 1.27mmピッチ格子の表面実装型PGAパッケージに適合
- ゼロ挿抜力機構により、リードの損傷を防止
- 2点接触方式により、高い接触信頼性を実現
- レバー押し下げによる開閉機構を採用し、自動機にも対応
- 最大37×37グリッド、600ピン対応



製品仕様

材料及び処理

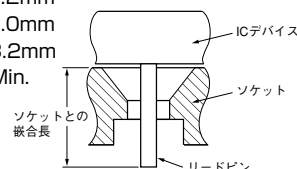
ボディ	ガラス入りPEI樹脂	UL94V-0、色調:黒
コンタクト	ベリリウム銅	ニッケル下地金メッキ
カムレバーパーツ	ステンレス鋼	Eリング、ワッシャー含む
スクリュー	ステンレス鋼	No.0-80UNF
平座金	ステンレス鋼	付属パーツ
ばね座金	ステンレス鋼	付属パーツ
ナット	ステンレス鋼	付属パーツ

定 格

定格電流	1.0A MAX(25°C)
使用温度	-55°C~+150°C

適合対象

適合パッケージ	適合基板(推奨)
以下の仕様のSPGAパッケージと適合する。	基板厚 端子長さAタイプ…1.6mm
リード径 $\phi 0.20 \pm 0.05\text{mm}$	Bタイプ…3.2mm
リードのソケットとの嵌合長 Min.1.4mm Max.1.8mm	Cタイプ…5.0mm
リード数 最大600ピン	Dタイプ…3.2mm
マトリックス 37×37、11列以内	スルーホール径 $\phi 0.4\text{mm Min.}$
リード表面処理 金メッキ	



関連規格

MIL-STD-202F, UL94V-0

機械的特性

開閉耐久性	開閉回数 10,000回(常温)
操作力	初期 0.09N/Pin (9gf/Pin) 以下

電気的特性

耐電圧	AC700V RMS1分間
絶縁抵抗	1000M Ω 以上(DC500V)
接触抵抗	初期値 50m Ω 以下(1.5mA)

オーダーインフォメーション

2XXX-1361-S□-3302

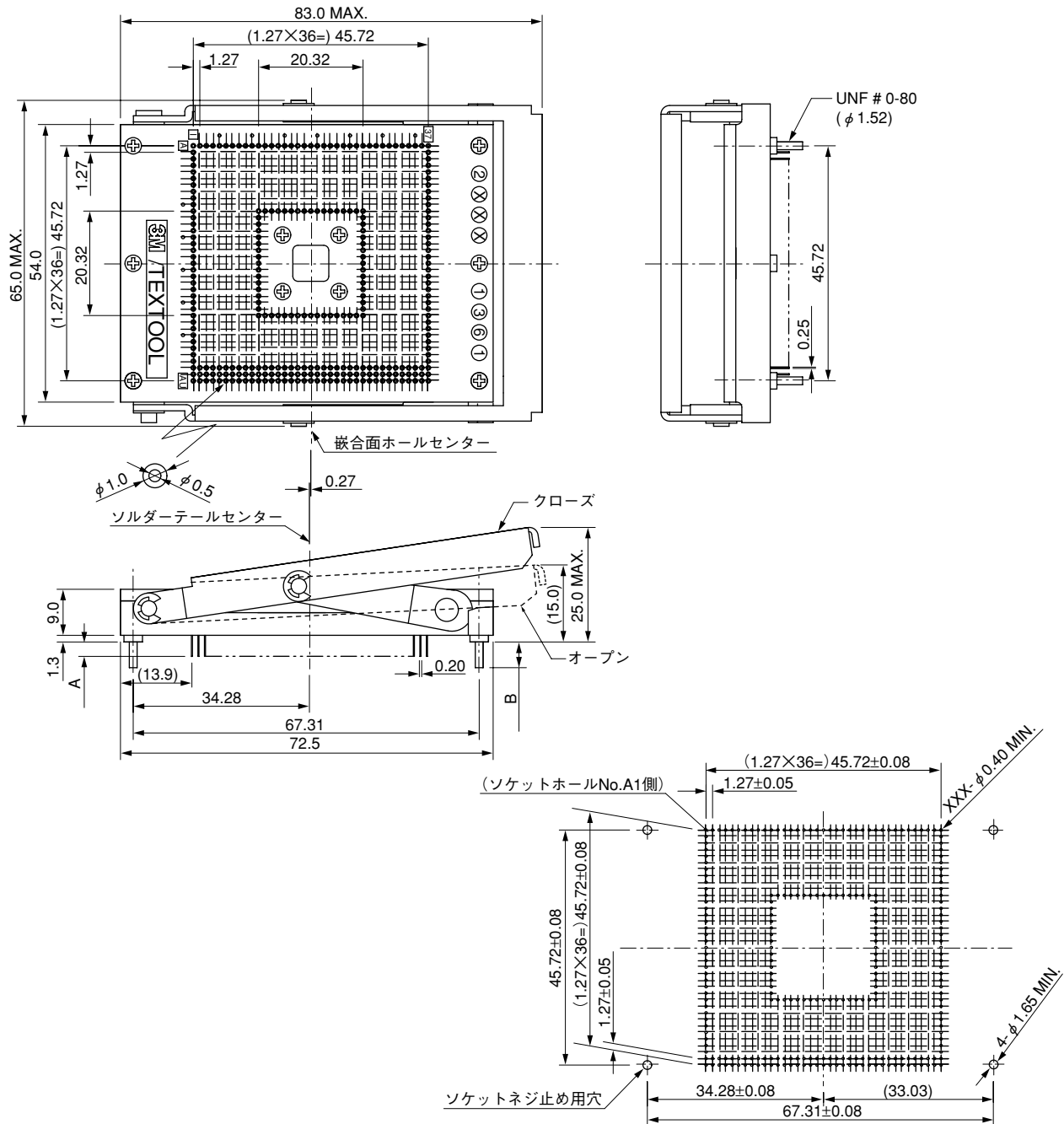
端子長さ (mm)
 A : 2.8
 B : 4.3
 C : 6.0
 D : 4.3

コンタクト数 (最大600ピン)

● SPGAソケットは標準のピン配列はございません。

オーダーの際は、ピン数、ピン配列、端子の長さ指定を、E-3ページに掲載されているワークシートにご記入下さい。

SPGAソケット



PCB ホールパターン参考図 (ソケット実装面側)

製品番号	A	B	適合基板厚さ
2xxx-1361-SA-3302	2.8	4.2	1.6
2xxx-1361-SB-3302	4.3	7.2	3.2
2xxx-1361-SC-3302	6.0	7.2	5.0
2xxx-1361-SD-3302	4.3	11.2	3.2

指定寸法公差		
寸法	.0	.00
公差	±.3	±.13

単位 : mm